

2025-2031年中国印制电路板（PCB）行业分析与投资前景预测报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2025-2031年中国印制电路板（PCB）行业分析与投资前景预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202503/480527.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

PCB（PrintedCircuitBoard），中文名称为印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，主要由绝缘基材与导体两类材料构成，在电子设备中起到支撑、互连的作用。采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错，提高了自动化水平和生产劳动率。随着印刷电路板应用场景的不断拓展，下游产品不断创新，印刷电路板一般可分为刚性电路板、软性电路板、金属基电路板、HDI板和封装基板。

PCB行业的周期性受宏观经济波动的影响。随着电子信息产业的不断发展，PCB行业下游应用领域越来越广泛，涉及通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等众多领域。总体而言，PCB行业受单个行业波动影响较小，宏观经济波动及电子信息产业整体发展状况对行业的影响较大。

从全球角度看，全球PCB行业下游应用领域广泛，因而受单一下游行业影响较小。2020-2024年全球印制电路板产值整体呈增长趋势。2024年，全球印制电路板市场规模约为804.49亿美元。当前，中国已成为全球最大PCB生产国，占全球PCB行业总产值的比例超过50%。从中国看，2024年，中国大陆PCB行业产值整体规模达350.09亿美元，占全球PCB行业总产值的比例为53.68%；2024年，中国大陆PCB市场增长迅速，规模达到了436.16亿美元，增幅24.59%。在我国印制电路板细分产品中，2024年，多层板市场占比最大，约为44.86%；其次是挠性板和HDI板，市场占比约为17.37%和17.34%。

在投融资方面，2024年-2024年，PCB市场前景受新兴应用行业的引领，企业纷纷融资布局PCB生态链，加大企业PCB核心技术的研发，扩建生产线提升产能，为未来几年的PCB新应用市场做规划。圆周率半导体是一家电路板产品研发生产商，集研发、设计、制造和组装于一体，专注于生产和研发ATE、MLO、HDI和IC载板等电路板产品。2024年4月，圆周率半导体获得A轮投资，该轮投资由国发创投和凯胜创投参与投资。此前，2024年8月圆周率半导体获得元禾原点投资的天使轮融资。

2024年12月27日，国家发展和改革委员会公布《鼓励外商投资产业目录（2024年）》，将“高密度互连积层板、单层、双层及多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板、高密度高细线路(线宽/线距 $\leq 0.05\text{mm}$)柔性电路板”列入全国鼓励外商投资产业目录。

中企顾问网发布的《2025-2031年中国印制电路板（PCB）行业分析与投资前景预测报告》共十五章。首先介绍了PCB的定义、PCB的产业链等，接着对目前国内外PCB行业的发展做了解析，然后分析了PCB行业上游原料市场、中游产品以及下游应用领域的发展现状，并对国内PCB行业的地区。接着，报告对国内外PCB重点企业的运营状况做了分析。最后，报告对PCB的典型投资项目做了详细的介绍，并对其行业发展前景进行了科学的预测。

本研究报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、商务部、财政部、中企顾问网、中企顾问网市场调查中心、中国印制电路行业协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对PCB行业有个系统的了解、或者想投资PCB行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

报告目录：

第一章 印制电路板（PCB）概况

1.1 PCB介绍

1.1.1 PCB定义

1.1.2 PCB特征

1.1.3 PCB应用领域分析

1.2 PCB产品链及产品分析

1.2.1 PCB产业链

1.2.2 PCB产品类型

1.2.3 PCB主要产品

第二章 2020-2024年全球PCB行业发展情况综述

2.1 全球PCB产业发展现状全球PCB行业整体表现

2.1.1 全球PCB产业规模状况

2.1.2 全球PCB区域分布状况

2.1.3 全球电子终端需求驱动

2.1.4 全球PCB下游应用领域

2.1.5 全球PCB主要厂商分布

2.1.6 全球PCB市场空间预测

2.2 全球PCB行业主要产品市场发展格局

2.2.1 挠性板

2.2.2 多层板

2.2.3 HDI板

2.2.4 封装基板

2.3 PCB行业主要国家发展分析

2.3.1 美国PCB行业发展

2.3.2 日本PCB行业发展

2.3.3 韩国PCB行业发展

第三章 2020-2024年中国PCB行业发展环境分析

3.1 宏观经济环境

3.1.1 宏观经济概况

3.1.2 对外经济分析

3.1.3 工业运行情况

3.1.4 固定资产投资

3.1.5 宏观经济展望

3.2 电子信息制造业运行情况

3.2.1 总体运营情况

3.2.2 固定资产投资

3.2.3 通信设备制造业

3.2.4 电子元件制造业

3.2.5 电子器件制造业

3.2.6 计算机制造业

3.3 PCB行业政策环境

3.3.1 行业规范条件

3.3.2 产业结构目录

3.3.3 环保政策影响

第四章 2020-2024年中国PCB行业市场运行情况

4.1 中国PCB行业市场发展情况

4.1.1 PCB行业市场规模

4.1.2 PCB行业产业转移

4.1.3 PCB细分产品结构

4.1.4 PCB下游应用市场

4.2 中国PCB行业竞争格局

4.2.1 PCB企业竞争格局

4.2.2 PCB产业集群分布

4.2.3 内资企业发展现状

4.2.4 PCB企业融资情况

- 4.2.5 行业规范条件符合企业
- 4.2.6 PCB企业集中发展趋势
- 4.3 PCB行业技术热点
 - 4.3.1 制造技术提升
 - 4.3.2 设计重要性突显
 - 4.3.3 基板材料高性能化
 - 4.3.4 高性能要求高可靠
- 4.4 PCB行业主要进入壁垒分析
 - 4.4.1 资金壁垒
 - 4.4.2 技术壁垒
 - 4.4.3 环保壁垒
 - 4.4.4 客户认可壁垒

第五章 2020-2024年中国柔性电路板（FPC）发展情况分析

- 5.1 柔性电路板（FPC）概述
 - 5.1.1 FPC产品介绍
 - 5.1.2 FPC制备流程
 - 5.1.3 FPC发展进程
 - 5.1.4 FPC应用领域
- 5.2 FPC市场运行情况分析
 - 5.2.1 FPC行业市场规模
 - 5.2.2 FPC行业供需状况
 - 5.2.3 FPC行业应用规模
 - 5.2.4 FPC产品市场价格
 - 5.2.5 FPC行业集中度
 - 5.2.6 FPC行业竞争格局
 - 5.2.7 国内厂商发展情况
 - 5.2.8 FPC产业转移进程
- 5.3 FPC应用领域发展分析
 - 5.3.1 单机FPC价值量
 - 5.3.2 射频天线创新需求
 - 5.3.3 汽车FPC应用

5.3.4 工控医疗应用

第六章 2020-2024年PCB行业上游原材料市场运行分析

6.1 PCB行业上游原材料简析

6.2 PCB用铜箔市场分析

6.2.1 铜箔概况

6.2.2 市场需求

6.2.3 价格走势

6.2.4 产能规模

6.3 PCB玻纤市场发展情况

6.3.1 玻纤材料介绍

6.3.2 玻纤性能要求

6.3.3 玻纤需求分析

6.3.4 玻纤市场现状

6.3.5 市场进入壁垒

6.4 PCB其他原料发展分析

6.4.1 PCB油墨

6.4.2 PCB化学品

6.4.3 PCB磷铜球

第七章 2020-2024年PCB行业中游市场分析——覆铜板

7.1 覆铜板概述

7.1.1 覆铜板介绍

7.1.2 覆铜板分类

7.1.3 生产工艺流程

7.2 覆铜板主要产品发展情况

7.2.1 刚性覆铜板

7.2.2 挠性覆铜板

7.2.3 半固化片

7.3 覆铜板市场运行情况

7.3.1 市场运行情况

7.3.2 市场需求情况

- 7.3.3 行业竞争格局
- 7.3.4 行业进入壁垒
- 7.3.5 行业发展趋势
- 7.4 2020-2024年中国印制电路用覆铜板进出口数据分析
 - 7.4.1 进出口总量数据分析
 - 7.4.2 主要贸易国进出口情况分析
 - 7.4.3 主要省市进出口情况分析

第八章 2020-2024年PCB行业下游应用领域——消费电子

8.1 消费电子及相关PCB产品应用分析

- 8.1.1 消费电子市场发展现状
- 8.1.2 消费电子PCB要求
- 8.1.3 消费电子PCB市场
- 8.1.4 PCB厂商业务布局

8.2 类载板（SLP）发展情况分析

- 8.2.1 SLP发展进程
- 8.2.2 手机SLP价值
- 8.2.3 技术发展趋势

8.3 消费电子PCB发展市场空间

- 8.3.1 5G手机用板需求
- 8.3.2 SLP市场发展空间
- 8.3.3 智能穿戴设备应用

第九章 2020-2024年PCB行业下游应用领域——汽车电子

9.1 汽车电子行业发展综述

- 9.1.1 汽车电子概念
- 9.1.2 汽车电子分类
- 9.1.3 汽车电子产业链
- 9.1.4 汽车电子成本占比

9.2 汽车领域PCB应用介绍

- 9.2.1 汽车用PCB需求
- 9.2.2 汽车用PCB种类

- 9.2.3 PCB汽车应用领域
- 9.2.4 汽车PCB价值分析
- 9.3 汽车PCB市场运行情况
 - 9.3.1 产业市场规模
 - 9.3.2 企业产品布局
 - 9.3.3 企业发展格局
- 9.4 汽车PCB发展市场空间分析
 - 9.4.1 车用PCB价值量简析
 - 9.4.2 新能源汽车PCB应用
 - 9.4.3 汽车智能化PCB需求

第十章 2020-2024年PCB行业下游应用领域——通信设备

- 10.1 通讯设备发展情况
 - 10.1.1 4G基站设备PCB应用
 - 10.1.2 中国5G建设现状简析
 - 10.1.3 5G基站PCB市场空间
 - 10.1.4 基站的PCB用量对比
- 10.2 通讯领域PCB应用分析
 - 10.2.1 通讯领域PCB应用
 - 10.2.2 通信PCB产品需求
- 10.3 通信领域PCB市场运营情况
 - 10.3.1 市场规模分析
 - 10.3.2 竞争格局分析
 - 10.3.3 企业发展状况
- 10.4 通信领域PCB行业进入壁垒分析
 - 10.4.1 技术壁垒
 - 10.4.2 投资壁垒
 - 10.4.3 认证壁垒

第十一章 2020-2024年中国PCB行业地区发展情况综述

- 11.1 台湾地区PCB发展简析
 - 11.1.1 台湾PCB进出口情况

- 11.1.2 台湾PCB市场规模
- 11.1.3 台湾PCB厂商营收
- 11.1.4 台湾PCB发展蓝图
- 11.1.5 台湾PCB智慧制造
- 11.1.6 台湾PCB智慧发展
- 11.2 广东省PCB行业发展分析
 - 11.2.1 PCB行业发展格局
 - 11.2.2 PCB行业相关政策
 - 11.2.3 PCB项目融资动态
 - 11.2.4 PCB智能制造试点
- 11.3 江西省PCB行业发展分析
 - 11.3.1 地区发展现状
 - 11.3.2 行业政策规划
 - 11.3.3 项目建设动态

第十二章 中国PCB行业项目投资建设案例深度解析

- 12.1 柔性多层印制电路板扩产项目
 - 12.1.1 项目基本概述
 - 12.1.2 投资价值分析
 - 12.1.3 建设内容规划
 - 12.1.4 资金需求测算
 - 12.1.5 实施进度安排
 - 12.1.6 经济效益分析
- 12.2 高阶HDI印制电路板扩产项目
 - 12.2.1 项目基本概述
 - 12.2.2 投资价值分析
 - 12.2.3 建设内容规划
 - 12.2.4 资金需求测算
 - 12.2.5 实施进度安排
 - 12.2.6 经济效益分析
- 12.3 挠性印制电路板建设项目
 - 12.3.1 项目基本概述

- 12.3.2 投资价值分析
- 12.3.3 资金需求测算
- 12.3.4 实施进度安排
- 12.3.5 项目效益分析

第十三章 2020-2024年国外PCB重点企业发展分析

- 13.1 旗胜（NipponMektron）
 - 13.1.1 企业发展概况
 - 13.1.2 企业布局动态
 - 13.1.3 2024年财年企业经营状况分析
 - 13.1.4 2024财年企业经营状况分析
 - 13.1.5 2024财年企业经营状况分析
- 13.2 迅达（TTM）
 - 13.2.1 企业发展概况
 - 13.2.2 2024年财年企业经营状况分析
 - 13.2.3 2024财年企业经营状况分析
 - 13.2.4 2024财年企业经营状况分析
- 13.3 三星电机
 - 13.3.1 企业发展概况
 - 13.3.2 2024年企业经营状况分析
 - 13.3.3 2024年企业经营状况分析
 - 13.3.4 2024年企业经营状况分析
- 13.4 藤仓（Fujikura）
 - 13.4.1 企业发展概况
 - 13.4.2 2024年财年企业经营状况分析
 - 13.4.3 2024财年企业经营状况分析
 - 13.4.4 2024财年企业经营状况分析

第十四章 2020-2024年中国PCB重点企业发展分析

- 14.1 健鼎科技股份有限公司
 - 14.1.1 企业发展概况
 - 14.1.2 2024年企业经营状况分析

- 14.1.3 2024年企业经营状况分析
- 14.1.4 2024年企业经营状况分析
- 14.2 欣兴电子股份有限公司
 - 14.2.1 企业发展概况
 - 14.2.2 2024年企业经营状况分析
 - 14.2.3 2024年企业经营状况分析
 - 14.2.4 2024年企业经营状况分析
- 14.3 深南电路股份有限公司
 - 14.3.1 企业发展概况
 - 14.3.2 企业业务布局
 - 14.3.3 经营效益分析
 - 14.3.4 业务经营分析
 - 14.3.5 财务状况分析
 - 14.3.6 核心竞争力分析
 - 14.3.7 公司发展战略
 - 14.3.8 未来前景展望
- 14.4 深圳市景旺电子股份有限公司
 - 14.4.1 企业发展概况
 - 14.4.2 企业经营模式
 - 14.4.3 经营效益分析
 - 14.4.4 业务经营分析
 - 14.4.5 财务状况分析
 - 14.4.6 核心竞争力分析
 - 14.4.7 公司发展战略
 - 14.4.8 未来前景展望
- 14.5 东山精密制造股份有限公司
 - 14.5.1 企业发展概况
 - 14.5.2 企业业务布局
 - 14.5.3 经营效益分析
 - 14.5.4 业务经营分析
 - 14.5.5 财务状况分析
 - 14.5.6 核心竞争力分析

- 14.5.7 公司发展战略
- 14.5.8 未来前景展望
- 14.6 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
 - 14.6.1 企业发展概况
 - 14.6.2 主要业务发展
 - 14.6.3 企业研发投入
 - 14.6.4 经营效益分析
 - 14.6.5 业务经营分析
 - 14.6.6 财务状况分析
 - 14.6.7 核心竞争力分析
 - 14.6.8 公司发展战略
 - 14.6.9 未来前景展望
- 14.7 沪士电子股份有限公司
 - 14.7.1 企业发展概况
 - 14.7.2 主要业务发展
 - 14.7.3 经营效益分析
 - 14.7.4 业务经营分析
 - 14.7.5 财务状况分析
 - 14.7.6 核心竞争力分析
 - 14.7.7 公司发展战略
 - 14.7.8 未来前景展望

第十五章 2025-2031年PCB行业投资分析及前景预测

- 15.1 PCB行业投资分析
 - 15.1.1 行业投资态势
 - 15.1.2 企业投资动态
 - 15.1.3 企业投资机遇
- 15.2 PCB行业发展前景分析
 - 15.2.1 PCB产业链布局方向
 - 15.2.2 5G基站PCB业务前景
 - 15.2.3 HDI产品发展机遇
 - 15.2.4 汽车PCB市场空间

15.2.5 PCB智能工厂前景

15.3 对2025-2031年中国PCB行业预测分析

15.3.1 2025-2031年中国PCB行业影响因素分析

15.3.2 2025-2031年中国PCB产值预测

15.3.3 2025-2031年中国柔性电路板市场规模预测

附录

附录一：印制电路板行业规范条件

图表目录

图表1 PCB在下游各领域中的运用

图表2 PCB产业链

图表3 按客户的不同阶段需求分类

图表4 样板与批量板对比

图表5 PCB分类（按基材柔软性）

图表6 PCB产品按导电涂层数分类

图表7 PCB产品按技术发展方向分类

图表8 多层板分类

图表9 HDI板生产工艺要求

图表10 封装基板按技术分类

图表11 2020-2024年全球PCB产值及增长速度

图表12 2024年全球PCB产值地区分布

图表13 2024年全球前40大PCB厂商季度营收增速（一）

图表14 2024年全球前40大PCB厂商季度营收增速（二）

图表15 2024年全球前40大PCB厂商季度营收增速（三）

图表16 2024年全球PCB下游应用领域分布

图表17 2024年全球PCB厂商TOP10

图表18 2020-2024年全球PCB产值预测

图表19 2020-2024年全球PCB各类板块产值情况及预测

图表20 2020-2024年全球PCB各类型产值复合增速预测

图表21 FPC全球产值

图表22 多层板产值细分

图表23 中低层板和高层板产值

图表24 HDI产值与PCB总产值增长率对比

图表25 2020-2024全球封装基板产值

图表26 2020-2024年国内生产总值及其增长速度

图表27 2020-2024年三次产业增加值占国内生产总值比重

图表28 2020-2024年货物进出口总额

图表29 2024年货物进出口总额及其增长速度

图表30 2024年主要商品出口数量、金额及其增长速度

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202503/480527.html>